

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-024

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元、万股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	93,948.06	54,551.06	72.22
营业利润	-14,357.26	-29,868.97	不适用
利润总额	-14,280.60	-29,867.37	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-10,939.77	-29,059.73	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-11,384.61	-30,020.48	不适用
基本每股收益 (元)	-0.27	-0.74	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-0.28	-0.76	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-7.56	-17.59	增加 10.03 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	185,966.41	181,033.63	2.72
归属于母公司的所有者权益	142,843.60	147,898.75	-3.42
股本	41,236.03	41,030.91	0.50
归属于母公司所有者的每股净资产 (元)	3.46	3.60	-3.89

注：

1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数，以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

#### 1. 经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入人民币 93,948.06 万元，较上年同期增加 72.22%；实现归属于母公司所有者的净亏损人民币 10,939.77 万元，与上年同期相比，亏损减少人民币 18,119.96 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损人民币 11,384.61 万元，与上年同期相比，亏损减少人民币 18,635.87 万元。

#### 2. 财务状况

2025 年末，公司总资产人民币 185,966.41 万元，较报告期初增加 2.72%；归属于母公司的所有者权益人民币 142,843.60 万元，较报告期初减少 3.42%，归属于母公司所有者的每股净资产人民币 3.46 元，较报告期初减少 3.89%。

#### 3. 影响经营业绩的主要因素

随着消费电子市场逐步回暖，叠加公司新品持续放量及海外市场拓展深化，终端客户需求较去年同期有所上升，公司的营业收入较上年同期实现显著增长，其中音圈马达驱动芯片产品线（即智能视觉感知业务）部分产品已逐步实现自主委外生产，使得该产品线的营收规模明显增长；此外，公司 2024 年 8 月末新增的传感器芯片产品线对公司本报告期的营收增长亦有所贡献。报告期内，随着公司总体业务规模的扩大，产品矩阵日益丰富，以及公司对上游供应链的有效整合，公司毛利润较去年同期有所增加。同时，随着市场逐步回暖，市场需求趋于稳定，存货的减值风险得到有效缓释，本报告期计提资产减值准备金额较去年同期有所减少。截至本公告披露日，相关资产减值测试尚在进行中，最终计提减值的金额

以会计师事务所审计确认为准。

## （二）主要财务数据增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

报告期内，公司的营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，变动幅度同比超过 30%。主要是报告期内公司受市场情况及音圈马达驱动芯片产品线部分产品生产调整为自主委托和传感器芯片产品线持续贡献的影响，营业总收入较 2024 年大幅增加；同时，公司业务规模的不断扩大、产品矩阵日益丰富及供应链整合优化带动毛利润的提升以及存货减值风险缓释使得资产减值损失的减少，综合推动公司亏损大幅收窄。

## 三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公司所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2025 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日